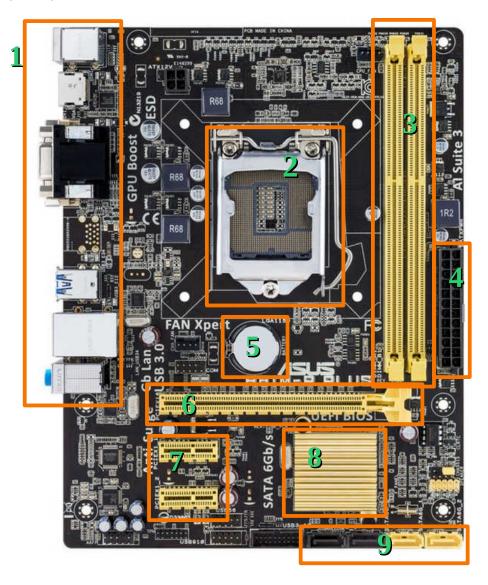
UD 03_Actividad 07 - ACTIVIDAD DE REPASO

A continuación encontrarás una colección de preguntas sobre los distintos temas incluidos en la unidad 03. Verás que hay de diferentes tipos, unas de respuesta muy corta y otras en que tienes que dar alguna explicación. En general, son preguntas del tipo de las que podrás encontrar en el examen correspondiente.

Deberás entregar los ejercicios 1, 3, 9 y 20. La realización del resto de ejercicios se considera voluntaria, su intención es ayudarte a revisar la materia, a manejar de nuevo los apuntes y los ejercicios realizados.

1. Dada la placa siguiente, identifica las partes numeradas y recuadradas e indica para qué sirven.



2. ¿A qué interfaces y con qué conectores suelen conectarse los dispositivos SSD?

3. Dadas la siguiente placa base, sus especificaciones y las especificaciones de diferentes microprocesadores y memorias, indica cuáles elegirías para la placa. Indica también el motivo por el que descartas los otros componentes.



	LGA1151 socket for 6th Generation Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processors			
	Supports Intel® 14nm CPU			
CPU	Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0*			
1000	* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.			
	** Refer to www.asus.com for Intel® CPU support list.			
Chipset	Intel® B150 Chipset			
	2 x DIMM, maxi. 32 GB, DDR4 2133 MHz, non-ECC, un-buffered memory*			
	Dual-channel memory architecture			
Memory	Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)			
	* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs. Please refer to Memory QVL (Qualified Vendors List) for details.			
<u> </u>	** Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors List).			
Graphics	Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics support			
	Multi-VGA output support: HDMI, DVI-D ports			
	Supports HDMI 1.4b with max. resolution of 4096 x 2160 @24Hz			
	Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200@60Hz			
	Supports Intel [®] InTru [™] 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider [™]			
	Maximum shared memory of 1024 MB			
Expansion Slots	1 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x16 mode)			
	Intel® B150 Chipset			
CALIFORNIA DE LA CALIFO	- 4 x Serial ATA 6.0Gb/s connectors			
Storage	 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242*/2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE x4 mode) 			
	* Support with M.2 2242 mounting kit.			

	Intel® Gigabit LAN
LAN	Anti-surge LANGuard
	GameFirst technology
Wireless (on selected	Speedy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac supports dual frequency band 2.4/5 GHz with MU-MIMO support
models)	Bluetooth v4.1
Audio	SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC
	- Supports Jack-detection, Multi-streaming, and Front Panel MIC Jack-retasking
	- High quality 112dB SNR stereo playback output
	Audio Features:
	- SupremeFX Shielding™ Technology
	- Headphone AMP
	- Optical S/PDIF out port at back panel
	- Sonic Radar II
USB	Intel® B150 Chipset - supports ASUS USB 3.0 Boost:
	 5 x USB 3.0/2.0 ports (2 ports at mid-board; 2 ports at back panel, blue; 1 port Type C at back Panel)
	- 4 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports at mid-board; 2 ports at back panel, black)

	1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
	1 x Optical S/PDIF out
	1 x HDMI port
	1 x DVI-D port
Rear Panel I/O Ports	1 x LAN (RJ-45) port
	1 x USB 3.0 Type-C port
	2 x USB 3.0/2.0 ports
	2 x USB 2.0 ports
	2 x Wi-Fi antenna ports (on selected models)
	8-channel audio I/O ports
	1 x 19-pin USB 3.0/2.0 connector supports additional 2 USB 3.0/2.0 port
	1 x USB 2.0/1.1 connectors support additional 2 USB 2.0/1.1 ports
	1 x System panel connector
	1 x Front panel audio connector (AAFP)
	4 x SATA 6.0 Gb/s connectors
Internal I/O Connectors	1 x M.2 Socket 3 for M Key, type 2242/2260/2280 devices
	1 x CPU fan connector (4-pin) for both 3-pin (DC mode) and 4-pin (PWM mode) CPU coolers control with auto detection support
	1 x Water pump connector (4-pin)
	1 x Chassis Fan connectors (4-pin) for both 3-pin(DC mode) and 4-pin(PWM mode) coolers control
	1 x Speaker header
	1 x TPM header
	1 x 24-pin EATX Power connector
	1 x 8-pin EATX 12V Power connector
	1 x Clear CMOS jumper (2-pin)

MICROPROCESADORES

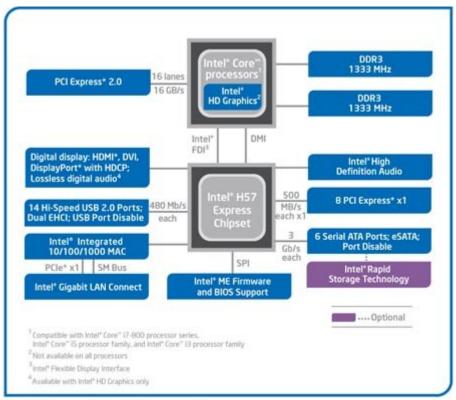
Número de procesador	E7-8880V3	i3-7101TE	i3-5005U
Estado	Launched	Launched	Launched
Fecha de lanzamiento	Q2'15	Q1'17	Q1'15
Litografía	22 nm	14 nm	14 nm
Precio de cliente recomendado	\$5895.00	\$117.00	\$275.00
<u>Desempeño</u>			
Cantidad de núcleos	18	2	2
Cantidad de subprocesos	36	4	4
Frecuencia básica del procesador	2,30 GHz	3,40 GHz	2,00 GHz
Frecuencia turbo máxima	3,10 GHz		
Caché	45 MB Last Level Cache	3 MB SmartCache	3 MB
Velocidad del bus	9,6 GT/s QPI	8 GT/s DMI3	5 GT/s DMI2
Cantidad de enlaces QPI	3		
TDP	150 W	35 W	15 W
Frecuencia de descenso de TDP configurable			600 MHz
Descenso de TDP configurable			10 W
Información adicional			
Opciones integradas disponibles	No	Sí	No
Libre de conflictos	Sí	Sí	Sí
Hoja de datos	Link	Link	Link
Especificaciones de memoria			
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo			
de memoria)	1,54 TB	64 GB	16 GB
Tipos de memoria	DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600	DDR3L-1600, DDR4-2400	DDR3L 1333/1600 LPDDR 1333 /1600
Cantidad máxima de canales de memoria	4	2	2
Máximo de ancho de banda de memoria	85 GB/s	34,1 GB/s	25,6 GB/s
Extensiones de dirección física	46-bit		
Compatible con memoria ECC ‡	Sí	Sí	
Especificaciones de paquete			
Zócalos compatibles	FCLGA2011	FCLGA1151	FCBGA1168

MEMORIAS

1 16GB Kit* (2x8GB) - DDR4 2133MHz Código de artículo: HX421S13IB2K2/16 HTS: 8473.30.1140 ECCN: EAR99 Especificaciones: DDR4, 2133MHz, Non-ECC, CL13, 1.2V, Unbuffered, SODIMM, PDF de la hoja de especificaciones 🗎 2 Savage Memory Red - 16GB Kit* (2x8GB) - DDR3 2133MHz Intel XMP CL11 Código de artículo: HX321C11SRK2/16 HTS: 8473.30.1140 ECCN: EAR99 Especificaciones: DDR3, 2133MHz, CL11, 1.6V, Unbuffered, PDF de la hoja de especificaciones [] Timings: 2133MHz, 11-12-12, 1.6V; 1600MHz, 9-9-9, 1.5V 3 32GB Kit* (2x16GB) - DDR4 2133MHz Código de artículo: HX421C14FBK2/32 HTS: 8473.30.1140 ECCN: EAR99 Especificaciones: DDR4, 2133MHz, Non-ECC, CL14, 1.2V, Unbuffered, DIMM , PDF de la hoja de especificaciones 🖺 Timings: 2133MHz, 14-14-14, 1.2V 4 32GB Module - DDR4 2133MHz Código de artículo: KTL-TS421/32G HTS: 8473.30.1140 ECCN: EAR99 Especificaciones: DDR4, 2133MHz, ECC, CL15, 1.2V, Registered, DIMM 5 Predator Memory Black - 32GB Kit* (2x16GB) - DDR4 3000MHz Intel XMP CL15 DIMM Código de artículo: HX430C15PB3K2/32 HTS: 8473.30.1140 ECCN: EAR99 Especificaciones: DDR4, 3000MHz, CL15, 1.35V, Unbuffered, PDF de la hoja de especificaciones Timings: 3000MHz, 15-17-17, 1.35V; 2666MHz, 15-17-17, 1.35V

- 4. ¿Qué tipos de memoria se utilizan en las tarjetas gráficas actuales?
- 5. ¿Qué es APU en el contexto del fabricante AMD?
- 6. Explica en qué consiste la jerarquía de memoria en un ordenador, de qué tipos de memoria está compuesta y por qué se ordenan de esa manera. (Sugerencia: incluye el esquema en forma de pirámide para ayudarte en la explicación)
- 7. ¿Cuáles son los parámetros principales en los nos fijamos al seleccionar un microprocesador? Da una breve explicación de cada uno.

- 8. ¿Cuáles son los parámetros principales en los nos fijamos al seleccionar la memoria RAM? Da una breve explicación de cada uno.
- 9. Si tuvieras que elegir un dispositivo SSD, ¿elegirías uno que se conectara a través de SATA o a través de PCle? Razona la respuesta.
- 10. Describe brevemente la arquitectura de Von Neumann (qué es, sus elementos y la función de cada uno dentro del conjunto).
- 11. Pensando en la arquitectura de Von Neumann, para leer/escribir de la memoria principal, ¿qué buses intervienen y para qué se utilizan?
- 12. Enumera algunos de los aspectos que se definen en la especificación del factor de forma de una placa base.
- 13. RAM son las siglas de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir "acceso aleatorio"?
- 14. ¿Qué tipo de memoria RAM es el más usual encontrar si vamos a comprar un ordenador de **escritorio actual**? Indica tecnología y tipo de encapsulado.
- 15. ¿Qué es el chipset? Explica de qué se compone, para qué sirve, dónde se ubica y si los chipsets actuales tienen la misma estructura ahora que hace unos cuantos años.
- 16. ¿Qué puedes explicar a partir este esquema?



Intel® H57 Express Chipset Platform Block Diagram

17. ¿Cuál de los siguientes tipos de buses es el más utilizado actualmente para la conexión de tarjetas gráficas: PCI, AGP, PCI Express?

- 18. Indica si la siguiente afirmación es cierta o falsa y por qué: "Para calcular la potencia de la fuente de alimentación de un ordenador, basta con sumar cada una de las potencias que consumen los distintos componentes y ver si no supera la potencia máxima suministrada por la fuente".
- 19. Identifica estos conectores del panel trasero de una placa base Hay seis bloques, numera los conectores de arriba hacia abajo en cada bloque:

B1: 1 _____; 2 ____; 3____

B2: 1 _____; 2 _____;

etc.



- 20. Acerca de interfaces para conectar dispositivos de almacenamiento, internas o externas.
 - a) ¿Cuáles son las interfaces actuales más usadas para conectar dispositivos de almacenamiento en entorno doméstico?
 - b) De cada una de ellas, ¿cuáles son las versiones que se suelen vender actualmente?
 - c) Si tuvieras que elegir una de ellas fijándote solamente en la velocidad de transferencia de datos, ¿cuál elegirías?
 - d) ¿Y si tuvieras que elegir entre USB y SATA?
- 21. ¿Qué solución de almacenamiento le propondrías a una persona que tiene que guardar grandes cantidades de datos y que quiere que su equipo arranque lo más rápido posible? Puedes indicar varios tipos de dispositivos y varias opciones según, por ejemplo, el presupuesto.
- 22. En el contexto de los monitores para ordenador, ¿qué es relación de aspecto y qué es resolución?
- 23. Si quisieras un monitor con mejor ángulo de visión y mejor representación del color, ¿por cuál te decantarías en principio, a falta de conocer más datos, por uno con panel TN o con panel MVA?

24. ¿A qué puede corresponder este panel? ¿Qué conectores ves en él?



- 25. ¿Qué es UEFI?
- 26. ¿Qué podemos hacer para descargarnos de electricidad estática antes de ponernos a montar un ordenador o de hacer algún cambio en el hardware de nuestro equipo?
- 27. ¿Qué tipo de fuente de alimentación puedes instalar si quieres minimizar la cantidad de cables dentro de la caja de tu ordenador?
- 28. ¿Qué es la pasta térmica? ¿Es necesario su uso?
- 29. (De la Unidad 02) Rellena los huecos de la tabla, para ello, realiza los cambios de base necesarios.

Decimal	Binario	Hexadecimal	Octal
125	1111101	7D	175
231			
	10010111		
		A2	
			321
	11001100		
		DE	
		211	
211			